

证券代码：301297

证券简称：富乐德

# 安徽富乐德科技发展股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	田毅潇 惠升基金；王晔 国联民生证券；杜先康 国海证券；林玲 上海勤辰资产管理；陈宇 铜冠投资；苗耀辉 趣时投资；崔健 银叶投资；强军 华泰证券；高宏 南京证券；戴宗廷 周焕博 国金证券；王火 沃富资本；王亮 广发证券；张铎 南土资产；于洋 循理资产；桂海晟 国泰海通；邵子豪 易方达
时间	2026年05月08日 9:30-11:00
地点	江苏富乐华半导体科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理 张恩荣 董事会秘书 颜华 富乐华董秘 刘立波 证券事务代表 李海东
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司业绩情况？ 答：公司已于2026年4月29日披露2025年年报及2026年一季报，其中，2025年度，公司实现营业收入2,866,526,437.56元，较上年同期增长7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润402,753,459.98元，较上年同期增长58.54%。具体业绩情况请见公司披露的相关公告。

2、公司洗净业务发展规划？

答：为巩固国内泛半导体设备精密洗净服务的领先地位，公司一方面将加强技术研发，布局先进制程洗净技术；另一方面将进一步布局新的洗净基地，以完善全国产能布局与基地建设规划。

3、富乐华业务情况？

答：公司全资子公司富乐华专注于覆铜陶瓷载板产品领域，拥有二十多年的研发、生产经验。其自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位，其产品主要包括直接覆铜陶瓷载板产品（DCB）、活性金属钎焊覆铜陶瓷载板产品（AMB）及直接镀铜陶瓷载板产品（DPC）产品。

4、DPC产品情况？

答：DPC产品通过磁控溅射、图形电镀实现陶瓷表面金属化，再通过表面处理提高载板抗氧化性和可焊性。DPC产品具有导热/耐热性好、图形精度高、可垂直互连及热膨胀系数与芯片匹配等诸多特性。相较于其它载板产品，DPC在线路精度上有明显优势，载板上下面互连的特性可满足高密度封装的条件。DPC产品主要应用于激光制冷器，未来在工业激光、车载激光、光通信等高端应用领域拥有广阔的应用前景。

5、杭州之芯发展情况？

答：2024年上半年，公司还完成对FT集团下属的杭州之芯半导体有限公司（以下简称“杭州之芯”）收购。这两类产品均系芯片制造过程中关键设备部件，均大量依赖进口、是我国被卡脖子设备部件之一。本次收购不仅有利于公司提升整体产品和服务整体竞争力，而且有利于公司整体业务、客户的协同。

2024年7月，公司完成收购杭州之芯半导体有限公司，为进入高端ALN加热器和ESC新品的翻新及新品制造打下基础。杭州之芯主要从事ALN加热器翻新与新品制作、静电吸盘ESC的研发、生产和销售。ALN加热器是一种晶圆精密加热的装置，主要用于化学沉积CVD、原子层沉积系统ALD和等离子体增强化学气相沉积等应用场景；ESC静电吸盘是一种适用于真空及等离子体工况环境的晶圆承载体，系目前芯片高端装备刻蚀机ETCH、离子注入机、化学沉积CVD、物理气相沉积PVD等设备的核心部件。根据业绩承诺，杭州之芯2025年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到940万元，2025年度实际完成1,268.1万元，超额完成了业绩承诺。

	<p>6、未来的分红政策是怎样的？</p> <p>答：在回报股东方面，公司一直秉持着积极、稳定的原则。2025年度利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。若该预案获股东大会批准，叠加2025年第三季度已派发的现金，公司2025年度累计现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.44%，体现了公司致力于通过稳定现金分红回馈股东的决心。</p> <p>7、公司在技术研发方面有哪些投入和规划？</p> <p>答：技术创新是公司的核心驱动力。公司已建立了集清洗技术、涂层与表面处理技术、分析检测技术为一体的研发中心。凭借在洗净领域卓越的研发能力，并协同富乐华研究院的雄厚技术储备，我们将持续加大研发投入，不断丰富自主知识产权体系。未来紧跟下游行业的技术发展趋势，把握研发方向，通过应用新技术、推广新服务来满足客户不断变化的需求，保持市场竞争优势。</p> <p>8、公司如何看待未来的发展前景？</p> <p>答：我们对公司未来发展充满信心。一方面，国家大力支持半导体产业发展，国产替代趋势为公司带来了广阔的市场空间。另一方面，通过并购富乐华，公司成功切入半导体核心零部件赛道，形成了“服务+制造”的双轮驱动模式。公司将充分利用两个业务板块的协同效应，持续进行技术创新和市场拓展，致力于成为全球领先的泛半导体领域综合解决方案提供商，为投资者创造长期、稳定的回报。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年05月08日</p>